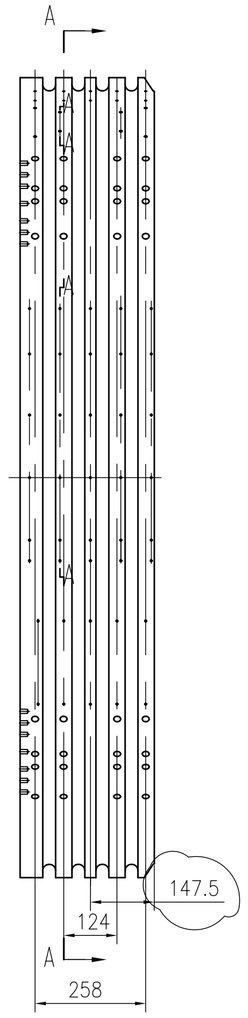
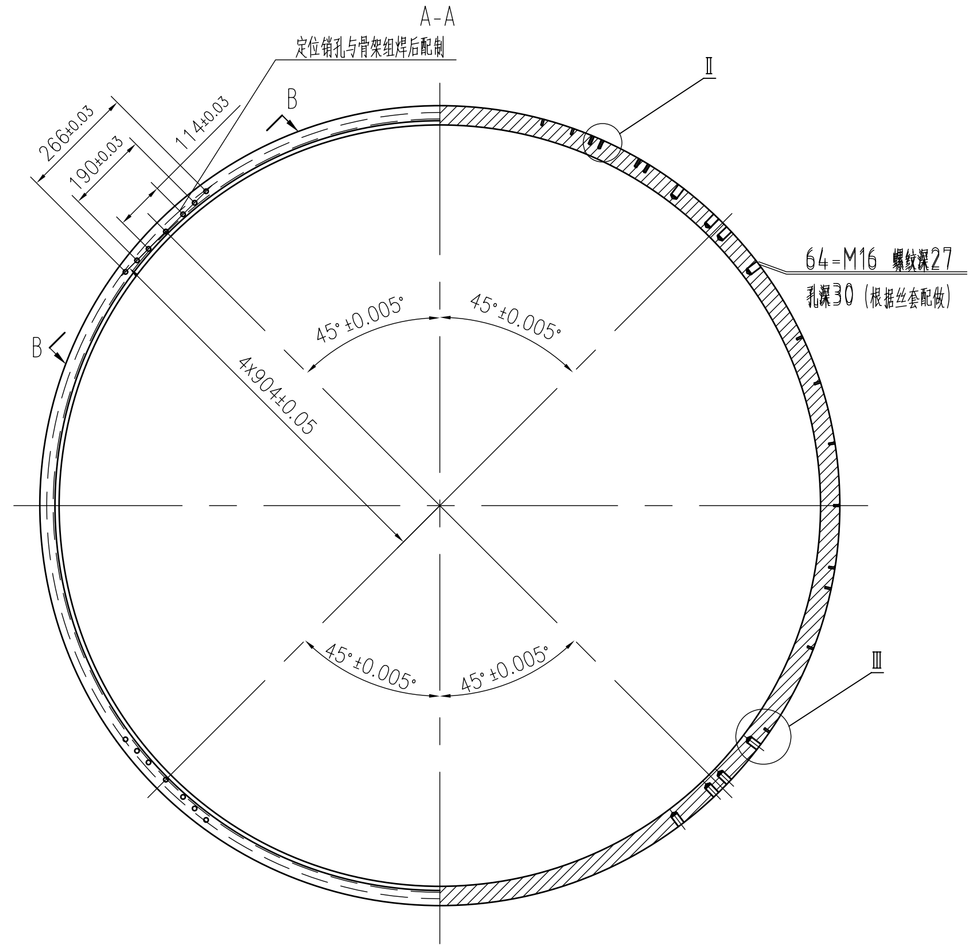
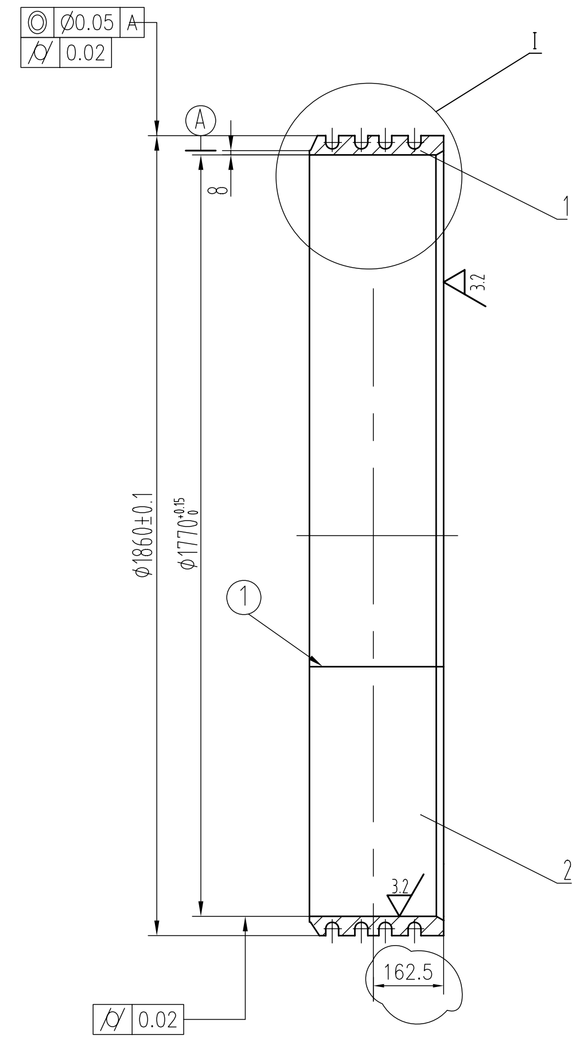
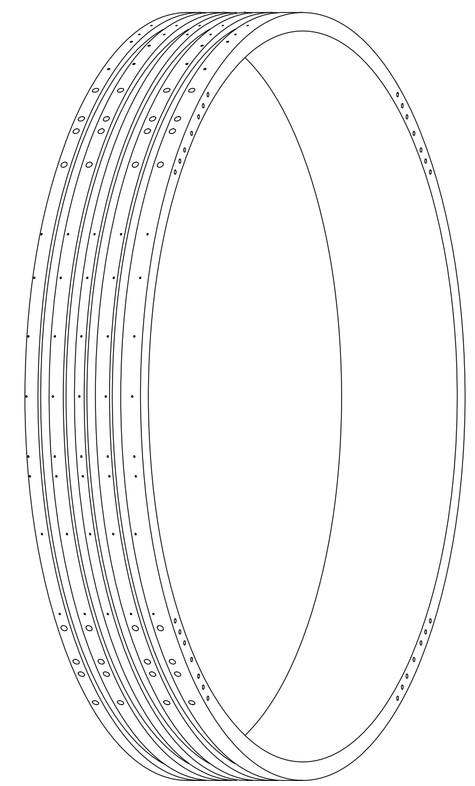
其余 63

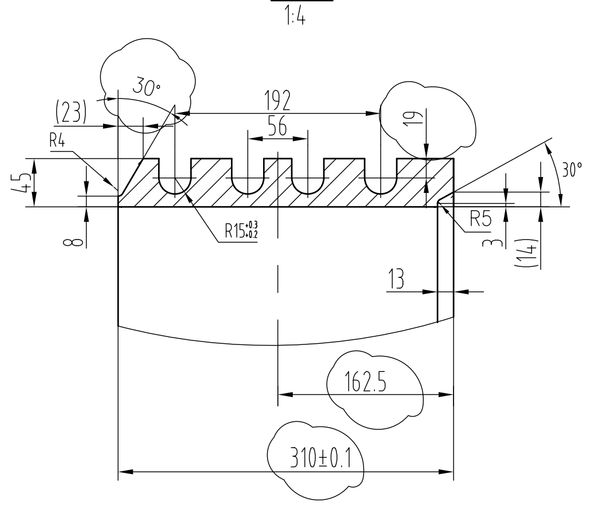




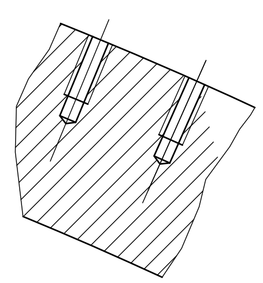




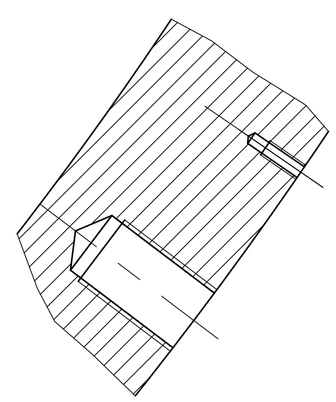
Ⅰ
1:4



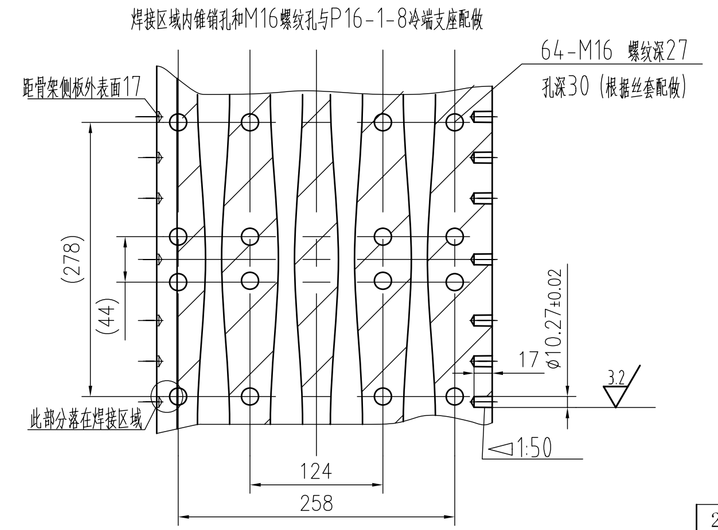
Ⅱ
1:1



Ⅲ
1:1



B-B旋转
1:4
4处



技术要求

1.提供材质证明书。

2.焊前应进行清洁处理，去除油脂、污垢、灰尘等后烘干或晾干，上下盖板应均分。

3.焊缝为全焊透形式，焊后不得有气孔、裂纹等影响强度的缺陷；按JB4730对接焊缝进行射线无损检测，Ⅱ级为合格，其他焊缝进行渗透检测，Ⅰ级为合格。

4.焊后根据变形情况确定是否进行粗加工；固熔和人工时效处理，消除残余应力；然后精加工。

5.未注尺寸公差按GB/T1804-2000-m级；
未注形位公差按GB/T1184-1996 K级。

6.采用焊接结构时，分别提供不同焊缝不同焊接工艺的焊接工艺试板及产品试板，骨架试板力学强度(δb)应至少达到200MPa；其它试板力学强度应至少达到140MPa每种试板不少于两块，力学试样要求符合相关国家标准。

7.允许整体锻制，加工成形；锻件整体材质状态性能均一稳定，圆周内外环各等分三处取试样试板，试板力学强度(δb)至少应达到240MPa，其它各项技术指标要求符合国家标准YS/T479-2005规定。

8.盖板应先加工外环面及冷却管槽，盖板应与冷却管先焊再加工，冷却管路与盖板焊接时，在冷端支座下及周向两侧50以内，应保留20×3走线槽不焊接。与冷却管焊接后，加工其他尺寸。

9.所有螺纹孔配制黄铜丝套。

10.先提保护组件等固定螺纹孔及黄铜丝套配做。

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
2	P16-1-3-2-002	下盖板	1	6061-T6			本图
1	P16-1-3-2-001	上盖板	1	6061-T6			本图

重量

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计			标准化	
校对			审定	
审核				
工艺			批准	

ICST 哈尔滨工业大学 低温与超导技术研究所

部件

MICE-CC

版本号	重量	比例
02	XX	1:10

盖板

共 张 第 张

P16-1-3-2

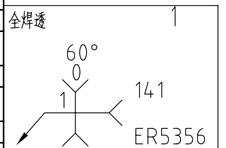
会签

借（通）用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

全焊透 1